51-я Международная Тулиновская конференция по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами (ФВЗЧК-2022)

# ИЗМЕНЕНИЕ ЗАРЯДОВОГО СОСТОЯНИЯ МОП-СТРУКТУР С РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫМ ЗАРЯДОМ ПРИ СИЛЬНОПОЛЕВОЙ ИНЖЕКЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ

Д.В. Андреев<sup>1</sup>, Г.Г. Бондаренко<sup>2</sup>, В.В. Андреев<sup>1</sup>, А.А. Столяров<sup>1</sup>

<sup>1</sup> МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал, Калуга, Россия <sup>2</sup> Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

# <mark>Аннотация</mark>

Изучено влияние режимов сильнополевой инжекции электронов на изменение зарядового состояния и дефектность МОП структуры после радиационного облучения. Рассматриваютвопросы стирания радиационнося индуцированного положительного заряла. накопленного в результате радиационного облучения, путем последующей сильнополевой по Фаулеру-Нордгейму инжекции электронов в подзатворный диэлектрик [1-4]. Показано, что для стирания положительного заряда необходимо использовать сильнополевую туннельную инжекцию электронов при электрических полях, не вызывающих генерацию дырок. Устарадиационноновлено, что стирание индуцированного положительного заряда в пленке SiO<sub>2</sub> МОП структур, а также генерация новых поверхностных состояний, в основном определяются величиной заряда, инжектированного в диэлектрик.

## Экспериментальные образцы

Исследуемые МДП-конденсаторы формировались на пластинах КЭФ-4,5 кристаллографической ориентацией <100>. Диоксид кремния толщиной 100 нм получали термическим окислением кремния в атмосфере кислорода при температуре 1000 °C с добавлением 3% HCl. Верхние электроды формировались с использованием фотолитографии по напыленной алюминиевой пленке. После формирования Alэлектродов проводили отжиг в среде азота при температуре 475 °C [1,3,4].



Рис.1. Фотографии полупроводникового кристалла исследуемых МОП-структур (а) и образцов, разваренных в корпус ИС (b)

#### <mark>Выводы</mark>

Показано, что для стирания радиационно-индуцированного положительного заряда, накапливаемого в пленке SiO<sub>2</sub> МОП структур, после радиационного воздействия желательно использовать сильнополевую туннельную инжекцию электронов при электрических полях, не вызывающих генерацию дырок. Установлено, что при аннигиляции захваченных в SiO<sub>2</sub> дырок в результате взаимодействия с инжектированными электронами, наблюдается существенное увеличение количества поверхностных состояний, значительно превышающих количество поверхностных состояний, возникающих при отжиге радиационно-индуцированного заряда при комнатной температуре. Предложена модель, описывающая процесс аннигиляции радиационно-индуцированного положительного заряда при послерадиационном взаимодействии с инжектированными электронами.

#### <mark>Модель</mark>

Для определения изменения плотности радиационно-индуцированных дырок, в процессе сильнополевой инжекции электронов, использовалось скорректированное [3,4] уравнение:

$$q\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = -J_{\mathrm{inj}} \cdot \sigma_{\mathrm{ep}} \cdot p$$

 уравнение для плотности тока Фаулера-Нордгейма:

$$J_{\rm inj} = AE^2 \exp\left(-\frac{B}{E}\right)$$

- уравнение для количества поверхностных состояний, генерируемых при аннигиляции захваченных дырок инжектированными электронами

$$\frac{\mathrm{d}n_{\mathrm{it}}^{\mathrm{e}\cdot\mathrm{h}}}{\mathrm{d}t} = \gamma_{\mathrm{e}\cdot\mathrm{h}} \frac{J_{\mathrm{inj}}}{q} \sigma_{ep} p(E,t) ,$$

 уравнение сдвига порогового напряжения МДП-структуры при инжекции электронов из кремния в режиме протекания постоянного тока можно определить по формуле:

$$\Delta V_{\rm T} = \frac{q}{\epsilon \varepsilon_0} \left[ p \left( d_{\rm ox} - x_{\rm p} \right) + n_{\rm it}^{\rm e-h} d_{\rm ox} - n_t \left( d_{\rm ox} - x_{\rm n} \right) \right],$$

где  $\sigma_{ep}$  – сечение захвата заполненными дырочными ловушками инжектированных электронов (при аннигиляции части положительного заряда), имеющее полевую зависимость  $\sigma_{ep}=b_0 \cdot E^{-3}$ , где  $b_0$  – параметр модели;  $N_t$ и  $\sigma_t$  – плотность и сечение захвата электронных ловушек в объеме диэлектрической пленки; q – заряд электрона; dox – толщина оксида; A=1,54·10<sup>-6</sup>·m<sub>0</sub>/m<sup>\*</sup>·φ<sub>B</sub><sup>-1</sup> [A/B<sup>2</sup>] B=6,83  $\cdot 10^7 \cdot m_0/m^* \cdot \phi_B^{3/2}$  [B/см] – постоянные туннельной по Фаулеру-Нордгейму инжекции; m<sub>0</sub> и m<sup>\*</sup> - масса электрона в вакууме и эффективная масса электрона в диэлектрике; фв - высота потенциального барьера на инжектирующей границе раздела; єє0 диэлектрическая проницаемость диэлектрика; x<sub>p</sub> и x<sub>n</sub> – положение центроидов (относительно границы Si-SiO<sub>2</sub>) положительного заряда захваченных в SiO2 дырок и захваченных электронов, соответственно.



Рис. 2. Изменение напряжения  $\Delta V_1$  на МДПструктуре, содержащей радиационноиндуцированный положительный заряд при последующей сильнополевой туннельной инжекции электронов из кремния в режиме протекания постоянного тока J<sub>inj</sub>=1 мкA/cm<sup>2</sup> (пунктирной линией показана теоретически рассчитанная кривая) и изменение напряжения плоских зон в процессе инжекции, а также количество поверхностных состояний от величины инжектированного заряда



Рис. 3. Плотность дырок, захваченных в подзатворном диэлектрике и количество вновь созданных поверхностных состояний от плотности инжектированных электронов

Из данных приведенных на рис. 3 видно, что для генерации одной поверхностной ловушки необходима аннигиляция 4 – 6 дырок (параметр модели γе-h лежал в диапазоне 0.15-0.25). Как видно из рис. 3 количество вновь созданных поверхностных состояний на участке, когда дырочный заряд имеет существенную величину практически совпадает экспериментальными данными приведенными на рис. 2.

## <mark>Литература</mark>

- Andreev D.V., Bondarenko G.G., Andreev V.V., Stolyarov A.A. Use of High-Field Electron Injection into Dielectrics to Enhance Functional Capabilities of Radiation MOS Sensors // Sensors. 2020. V.20. Is.8. P.2382(1-11).
- [2] Pejović M.M. Application of p-channel power VDMOSFET as a high radiation dose sensor// IEEE Trans. Nucl. Sci. Vol. 62 (2015) P.1905-1910.
- [3] Andreev V.V., Maslovsky V.M., Andreev D.V., Stolyarov A.A. Charge effects in dielectric films of MIS structures being under high-field injection of electrons at ionizing radiation// Proc. SPIE. International Conference on Micro- and Nano-Electronics 2018, 11022 (2019) 1102207(1-7).
- [4] Андреев Д.В., Бондаренко Г.Г., Андреев В.В., Масловский В.М., Столяров А.А. Зарядовые явления в диэлектрических пленках МДП-структур при одновременном воздействии радиационных излучений и сильнополевой инжекции электронов// Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2020. №3. С. 53-57.